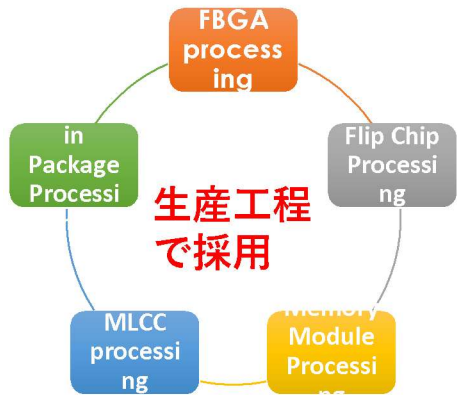


# 半導体Chip専用印刷機のご紹介



## 半導体Chip専用印刷機シリーズ主要仕様

	基板寸法	位置決め精度	繰返し印刷精度
US-2000XQX	250 × 350	± 12.5μm @ 6σ	± 25μm @ 6σ
US-2000BP	350 × 400	± 12.5μm @ 6σ	± 25μm @ 6σ
US-2000XT	250 × 330	± 12.5μm @ 6σ	± 25μm @ 6σ
US-3000	X pitch=140~165mm Y pitch = 75mm	± 12.5μm @ 6σ	± 25μm @ 6σ



Chip整列システム

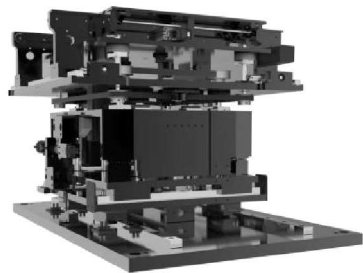


搬送カバー分離機構



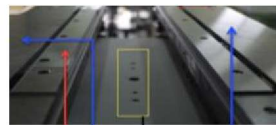
Chip毎整列システム

### X.Y.θ.Z駆動部



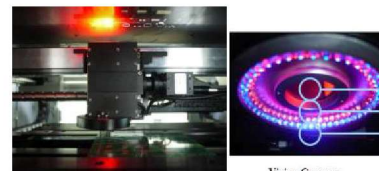
高剛性機構で繰返し高精度位置決と最適版離れ特性の実現

### 印刷テーブル部



Y.Z方向クランプで均一な印刷の実現

### 2D検査機能装備



基板とステンシルの整合と印刷結果確認が可能

### 精密スキージヘッド



エアとモーター制御で均一印刷を実現

### 簡単操作



リモートコントロールソフト内蔵

多様なオプション機能も提供できます